

所在地	東京都大田区大森西 1-16-1
事業内容	金属切削部品受託加工
資本金額	1600 万円
創業	1955 年
従業員数	38 人
自社紹介	当社は主に半導体製造装置、医療機器、超電導関連、官需製品などの部品を受注・生産していますが、昨今の半導体需要の高まりにより半導体製造装置向部品の受注が急増しています。そのため、ご協力いただける企業様を探しています。 主な得意先：キヤノン株式会社、三菱重工業株式会社、株式会社日立製作所 他 60 社
URL	<a href="https://horikoshi-seiki.co.jp/">https://horikoshi-seiki.co.jp/</a>

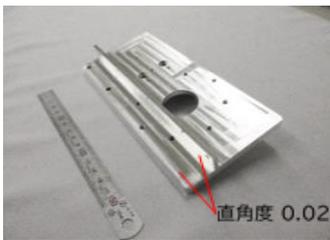
## 商談する受注側企業に求める技術や条件、認証など

技術：応力開放による歪みに対する対応など、相応の加工ノウハウを有していること。  
品質保証：各種測定機を使用し、寸法公差、幾何公差内での保障ができること。  
なお、公的認証の有無は問いません。

## 調達希望案件①

用途・品目	半導体製造装置向部品
材質	アルミ（主に A5052）
形状・寸法	概ね 100×150 程度（小さいものから大きなものまであり）
加工内容	フライス加工
必要な設備	フライス盤、マシニングセンタ、各種検査機器（3次元測定機など）
数量	1～50
その他	簡単なものから幾何公差（平面度、平行度、直角度）が厳しいものまであり

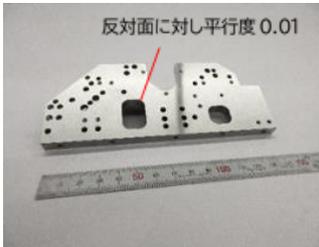
写真は代表例です。

## 調達希望案件②

用途・品目	半導体製造装置向部品
材質	鉄（炭素鋼）、ステンレス（SUS303/SUS304）
形状・寸法	概ね 100×150 程度（小さいものから大きなものまであり）
加工内容	フライス加工
必要な設備	フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、各種検査機器
数量	1～50
その他	簡単なものから幾何公差（平面度、平行度、直角度）が厳しいものまであり

写真は代表例です。

調達希望案件③	
用途・品目	半導体製造装置向部品
材 質	アルミ（主に A5056）
形状・寸法	φ50～180
加工内容	旋盤加工
必要な設備	汎用旋盤、NC 旋盤、NC 複合旋盤、マシニングセンサ、各種検査機器
数 量	1～50
そ の 他	光学系部品と同等の難易度
<p>写真は代表例です。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>基準円筒に対し、同軸度φ0.02</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>レンズ当たりにつき、バリカエリ無く、面取り不可</p>  </div> </div>	

調達希望案件④	
用途・品目	表面処理
材 質	鉄系、アルミ系、真鍮系
加工内容	無電解ニッケルめっき、アルマイト処理（普通、黒、艶消し黒など）
数 量	1～500（製品によりまちまち）
そ の 他	大田区内で自社集配されているところ歓迎。